



基于微孔隙增量表征CMCs在高温长时效诱发的损伤的方法

杨正茂^{*}; 闫涵; 龙丽平

2020-11-03

专利权人

中国科学院力学研究所

摘要

ZL201911008491.3基于微孔隙增量表征CMCs在高温长时效诱发的损伤的方法-杨正茂、闫涵、龙丽平

专利号

ZL201911008491.3

语种

中文

授权国家

中国

代理机构

北京和信华成知识产权代理事务所

文献类型

专利

条目标识符

http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/85502

专题

空天飞行科技中心

作者单位

中国科学院力学研究所

推荐引用方式

杨正茂,闫涵,龙丽平. 基于微孔隙增量表征CMCs在高温长时效诱发的损伤的方法. ZL201911008491.3[P]. 2020-11-03.

GB/T 7714

条目包含的文件

下载所有文件

文件名称/大小

文献类型

版本类型

开放类型

使用许可

ZL201911008491.3基于微孔 (113KB)

专利

开放获取

CC BY-NC-SA



浏览 下载

文件名: ZL201911008491.3基于微孔隙增量表征CMCs在高温长时效诱发的损伤的方法-杨正茂、闫涵、龙丽平.jpg
 格式: JPEG
 分辨率: 1080x1440



所有评论 (0)

[发表评论/异议/意见]

暂无评论

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

个性服务

推荐该条目

★ 保存到收藏夹

📊 查看访问统计

📄 导出为Endnote文件

Lanfanshu学术

Lanfanshu学术中相似的文章

[杨正茂]的文章

[闫涵]的文章

[龙丽平]的文章

百度学术

百度学术中相似的文章

[杨正茂]的文章

[闫涵]的文章

[龙丽平]的文章

必应学术

必应学术中相似的文章

[杨正茂]的文章

[闫涵]的文章

[龙丽平]的文章

相关权益政策

暂无数据

收藏/分享



QQ客服



官方微博



反馈留言